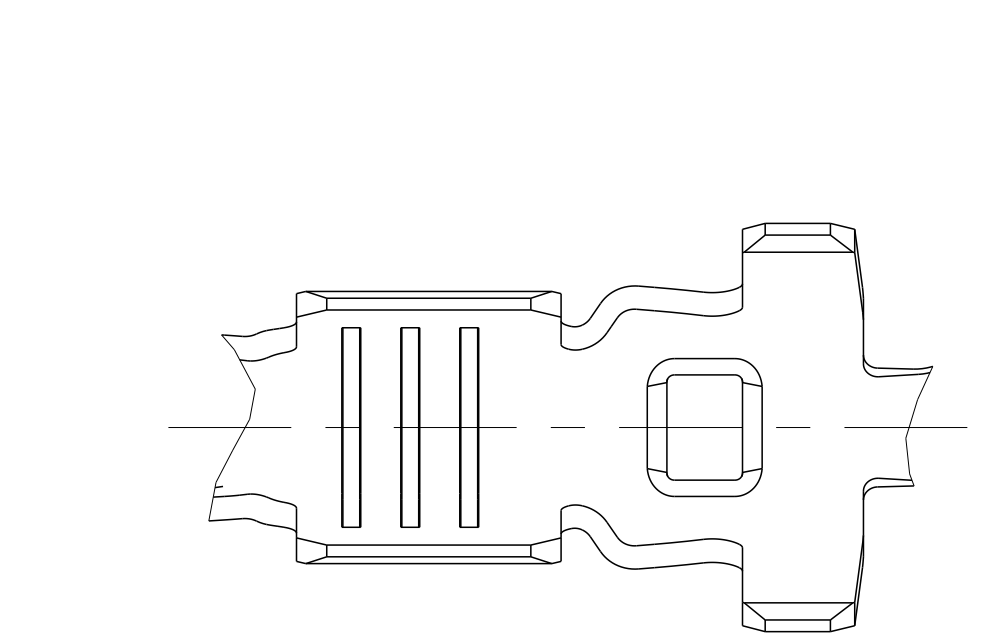
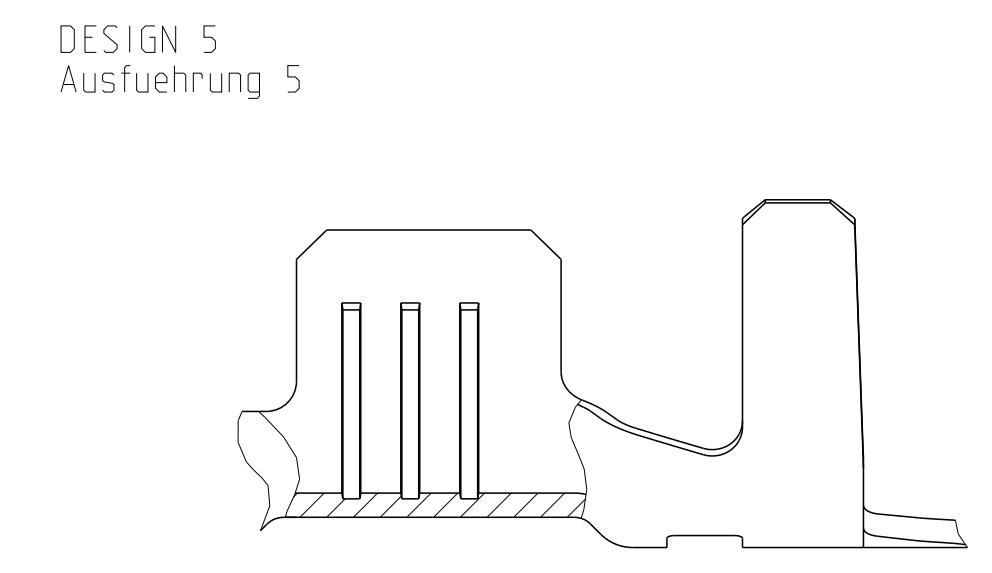
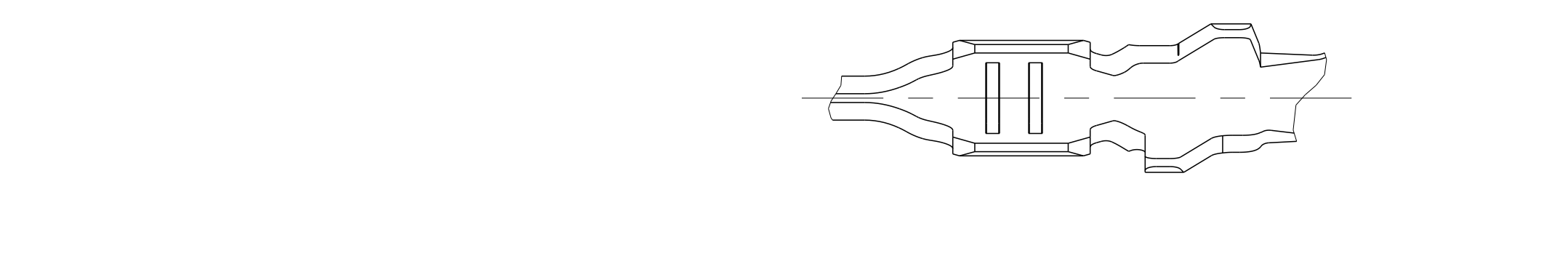
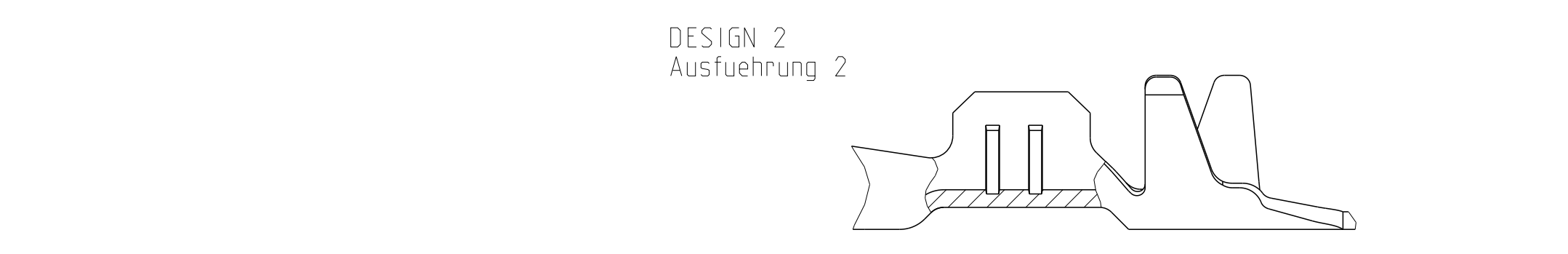
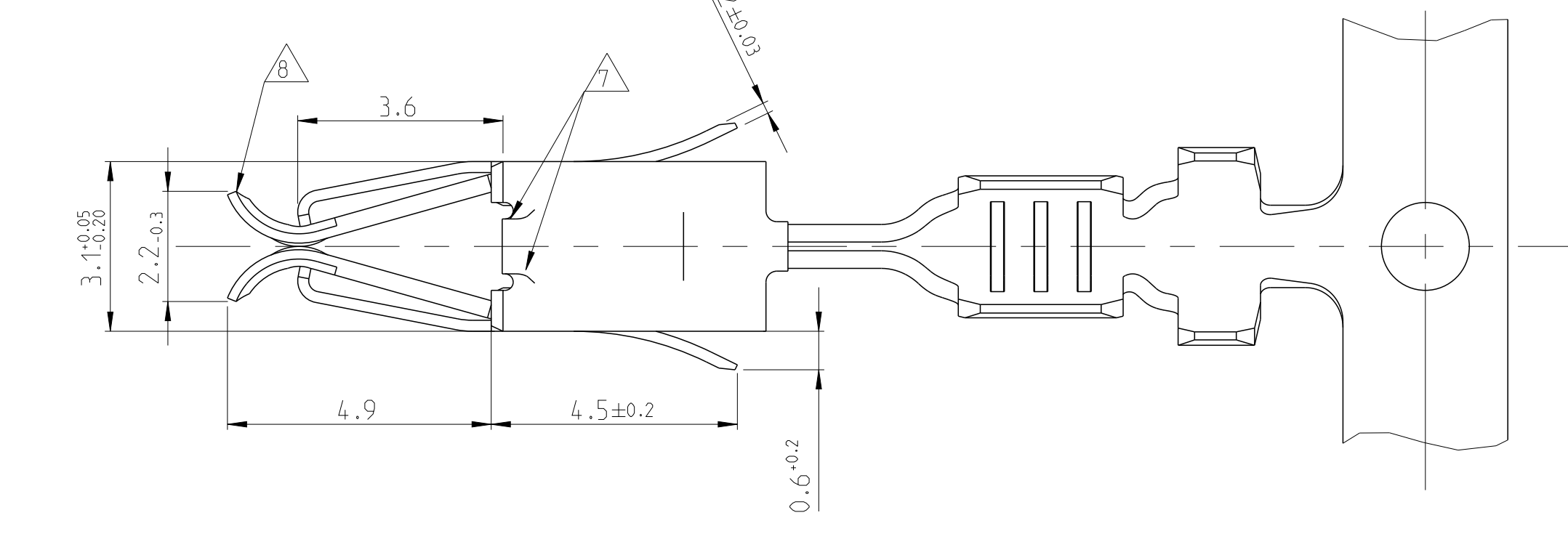
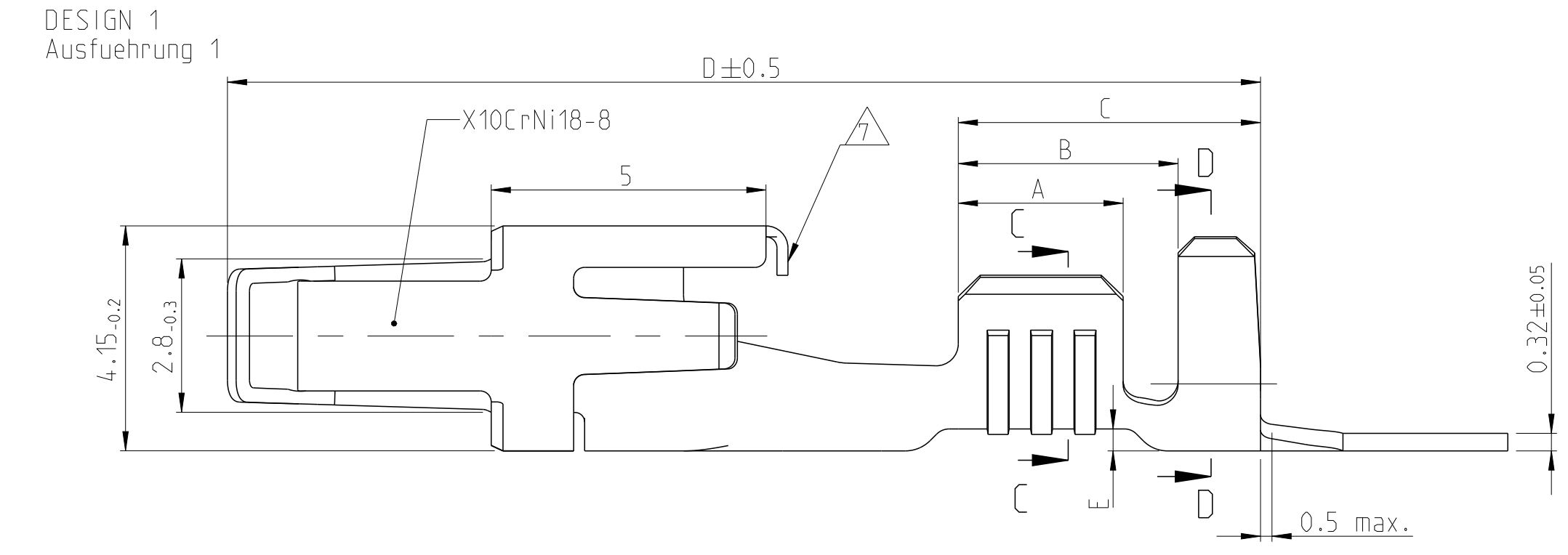


REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	WIRE RANGE Drahtgrößenbereich (mm <sup>2</sup> )	INSULATION Isolations Ø (mm)	STRIP FORM WIRE CRIMP Drahtcrimp Bandware	INSUL.-CRIMP Iso-Crimp	A	B	C	D	E	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4	
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4	
1	A	CuSn4	PLAIN BLANK	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4	
1	M	CuNi12Zn24	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.5-1.0 FLK	2.0-2.7	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.9 K = 4.1 D = 2.4	3	4	5.5	18.8	0.4	
1	M	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm										
1	M	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm										
1	M	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm										
1	A	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8	0.4	
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4	
1	N	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLK	2.7-4.1	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4	
1	R	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.1-3.1	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4	
1	R	CuFe2											
1	P	CuSn4											
1	P	CuFe2											
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.3	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	3	4	5.5	18.8	0.4	
1	N	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.2-0.5 FLR	1.0-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4	
1	N	CuFe2											
1	M	CuSn4											
1	M	CuFe2											
1	C	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.4 G = 2.3 D <sub>Dr</sub> = 1	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2	
1	C	CuFe2											
1	M	CuSn4											
1	M	CuFe2											
1	B	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.08-0.2 Sonderleitung	1.5-1.8	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>Dr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4	
1	A	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.2-0.5 FLR	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4	
1	D	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm	0.2-0.5 FLK	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 3.5 K = 3.6 D = 2.0	2.5	3.5	5	18.8	0.4	
1	C	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm										
1	C	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 0.8 µm										
1	A	CuSn4	PLAIN BLANK	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.4 G = 2.3 D <sub>Dr</sub> = 1	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	0.2	
1	E	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLK	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4	
1	E	CuFe2											
1	D	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	D	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	E	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	>1.0-2.5 FLR	2.7-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>Dr</sub> = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3.5	5.9	7.5	21	0.4	
1	E	CuFe2											
1	E	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	E	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	E	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	21	0.6	
1	E	CuFe2											
1	G	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	G	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	F	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>Dr</sub> = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	3	5.4	7	18.8	0.6	
1	F	CuFe2											
1	F	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	F	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	E	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	21	0.9	
1	E	CuFe2											
1	D	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	D	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	D	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>Dr</sub> = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5	4.9	6.5	18.8	0.9	
1	D	CuFe2											
1	C	CuSn4	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										
1	C	CuFe2	PRET INNED vorverzinkt min. 1 µm										

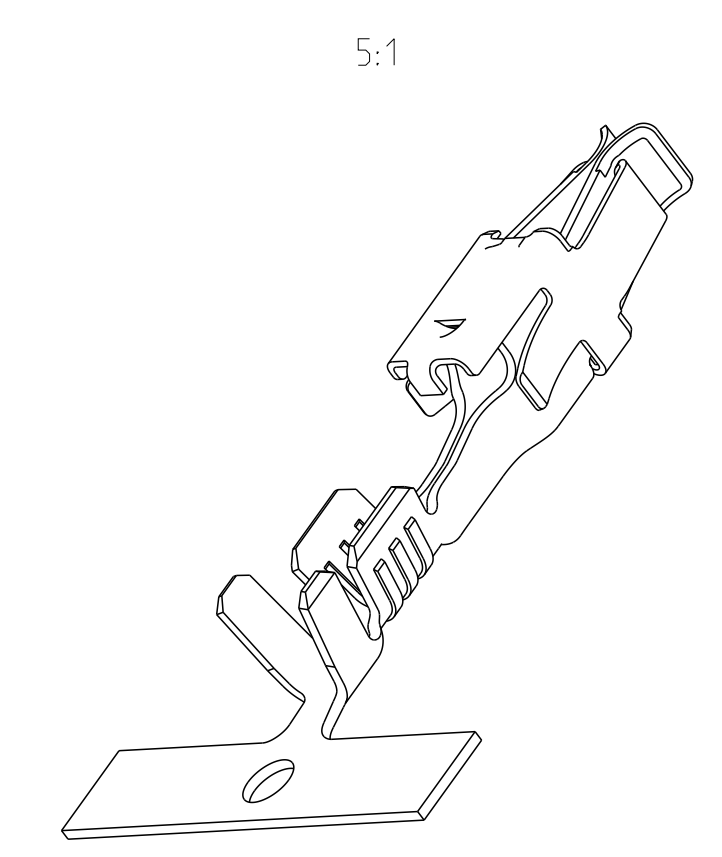
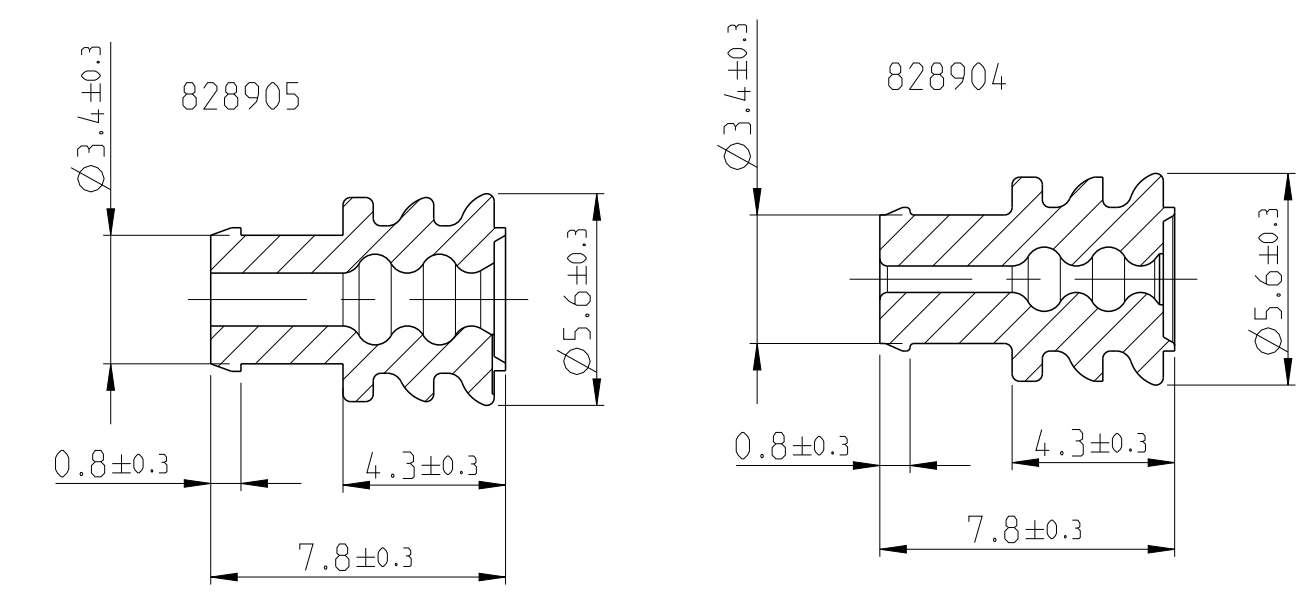
SEE APPLICATION - SPECIFICATION  
 siehe Verarbeitungspezifikation  
 114-18050



NOTES  
 Bemerkungen

- 1 CONTACT BODY PRE-SILVER PLATED MIN. 0.8 µm  
 Kontaktkoerper vorversilbert min. 0.8 µm  
 CONTACT ZONE SELECTIVE PRE-SILVER PLATED MIN. 3 µm  
 Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3 µm
- 2 CONTACT ZONE GOLD PLATED MIN. 0.8 µm OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER  
 Kontaktzone vergoldet min. 0.8 µm ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht  
 CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER  
 Crimpbereich min. 1 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht
- 3 CANTILEVER SPRING INSIDE AND OUTSIDE 0.4-1.2 µm GOLD PLATED  
 Ueberfeder innen und aussen 0.4-1.2 µm vergoldet
- 4 CONTACT BODY, CONTACT SPRING INSIDE AND CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER.  
 TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING AND CONTACT SPRING OUTSIDE  
 SELECTIVE 0.8 µm GOLD OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER  
 Kontaktkoerper, Kontaktfeder innen und Crimpbereich min. 1.3 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht, Anlageflaeche zur Ueberfeder und Kontaktfeder aussen selektiv 0.8 µm vergoldet ueber min. 1 µm Nickel-Zwischenschicht
- 5 CONTACT ZONE AND TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING MIN. 0.8 µm SELECTIVE GOLD PLATED OVER 1.3 µm NICKEL PLATED. CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER  
 Kontaktzone und Anlageflaeche zur Ueberfeder min. 0.8 µm vergoldet ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht Crimpbereich min. 1 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht
- 6 CONTACT BODY AND CRIMP AREA MIN. 1 µm TIN PLATED OVER NICKEL-LAYER.  
 TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING SELECTIVE 0.8 µm GOLD OVER MIN. 1.3 µm NICKEL-LAYER  
 Kontaktkoerper und Crimpbereich min. 1 µm verzinkt ueber Nickel-Zwischenschicht, Anlageflaeche zur Ueberfeder selektiv 0.8 µm vergoldet ueber min. 1.3 µm Nickel-Zwischenschicht
- 7 CONTACT OFF OPTIONAL  
 Abschnitt/Freisschnitt optional
- 8 SAWAG ONLY FOR PN 929937, 929939, 929941  
 Swage nur fuer PN 929937, 929939, 929941
- 9 VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.3mm (±0.1)  
 Varianten mit Gap-Size 0.3mm (±0.1)
- 10 CONTACTS DIPPED IN OR SPRAYED WITH LUBRICANT BARRIERTA  
 Kontakte getaucht oder besprueht mit Lubricant Barrierta
- 11 ACCORDING INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL  
 Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- 12 VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.65mm (-0.1)  
 Varianten mit Gap-Size 0.65mm (-0.1)
- 13 VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.15mm (-0.05)  
 Varianten mit Gap-Size 0.15mm (-0.05)

ORDER No. Bestell-Nr.	INSULATION Ø Isolations Ø	COLOUR Farbe
828904-1	1.2-2.1	blue blau
828905-1	2.2-3.0	white weiss



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)